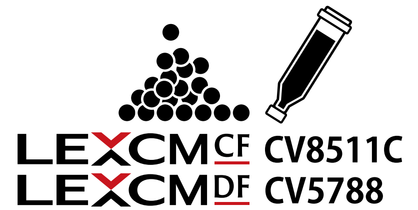
Panasonic INDUSTRY

Encapsulation Materials for FOWLP/PLP

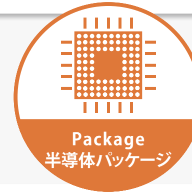
FOWLP/PLP用 半導体封止材



Applications 用途

Over-molding and wafer back-coating of advanced semiconductor packages, such as WLPs (FOWLPs and FIWLPs) and PLPs, for sophisticated mobile and wearable devices.

先端モバイル・ウエアラブルデバイス用先端半導体パッケージなどの WLP、PLP のオーバーモールド、ウエハバックコートなど



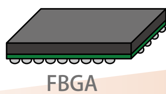
Available in forms of granule, liquid according to the required encapsulation thickness and size, enabling compression molding and lamination molding. Respond to growing size and low warpage of thin packages and contribute to the increased productivity of advanced semiconductor packages.

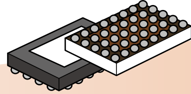
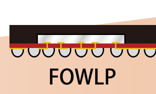
封止厚みと一括封止サイズに応じて、顆粒・液状のラインナップを保有し、圧縮成形に対応可能。薄型パッケージの大判化・低反りに対応し、先端半導体パッケージの生産性向上に貢献。

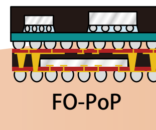
Low stress 低応力	Low shrinkage 低収縮率	Low temp.curability 低温硬化

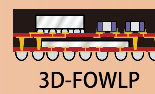
FOWLP Technology Trend　FOWLPの技術動向

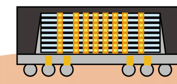
Contribute to low warpage and thinner product
低反りと薄型化に貢献



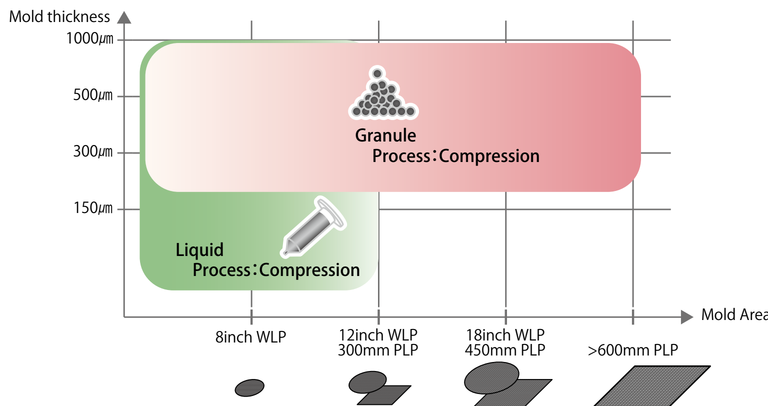




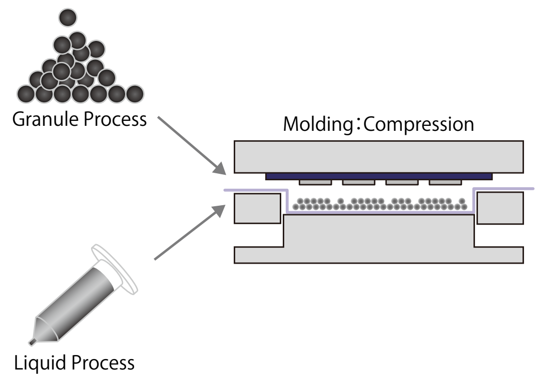


Each material and corresponding package　各封止方法の比較

We have wide range of Encapsulation Line-up for WLP/PLP
WLP/PLP 向けに幅広い封止材ラインアップを取り揃えています。



Encapsulation method　各材料の封止プロセス



General properties　一般特性

Item	Unit	CV8511C	CV5788
Mold Size	—	Wafer Level / Panel Level	
Process	—	Chip First / Chip Last	
Form	—	Granule	Liquid
Mold shrinkage	%	0.1	0.06
Glass transition temp. (Tg)	℃	210	180
C.T.E.1	ppm/℃	9	10
C.T.E.2	ppm/℃	52	49
F.Modulus (R.T.)	GPa	9	18

The written property values are just an example of our product line-up. Please contact us for details.　特性値はラインアップ中の一例であり、詳細はお問合せください。

industrial.panasonic.com/ww/electronic-materials
Panasonic Industry CV8511C CV5788

Panasonic Industry Co., Ltd. Electronic Materials Business Division
パナソニック インダストリー株式会社　電子材料事業部

Please see our website for Notes before you use.　商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

© Panasonic Industry Co., Ltd.　202212